

# 嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 A09 版)  
2019 年 1-9 月,公司实现营业收入 56,560.26 万元,较上年同期增长 8.43%,主营业务经营情况良好;营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长 24.38%、24.40% 和 32.77%,主要系公司营业收入和获得政府补助金额增加且毛利率水平上升所致;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 20.56%。2019 年 1-9 月,公司经营现金流量净额较上年同期减少 4,206.91 万元,主要系公司预期未来产品需求持续增长提前备货增加采购所致。

(二) 2019 年度预计业绩情况  
公司预计 2019 年的营业收入为 74,000 万元至 78,000 万元,较 2018 年增长 9.57%至 15.49%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,000 万元至 12,000 万元,较 2018 年增长 24.02%至 35.29%。上述财务数据为公司初步预估结果,未经审计机构审计或审阅,预估数不代表公司最终可实现收入及净利润,亦不构成公司盈利预测。

**第二节 本次发行概况**  
股票种类:人民币普通股(A股)  
每股面值:1.00 元  
拟发行股数:不超过 4,000 万股,最终以中国证监会核准的数量为准;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让。  
占发行后总股本的比例:不低于 25%  
每股发行价格:【1】元/股  
发行市盈率:【1】倍(按照确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算)  
发行前每股净资产:4.07 元(按 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)  
发行后每股净资产:【1】元(按 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司净资产和实际募集资金净额与发行后股本计算)  
发行市净率:【1】倍(按照发行后每股净资产计算)  
发行方式:采用网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他方式。  
发行对象:符合资格的询价对象和已在上交所开立证券账户的自然人、法人、机构投资者(国家法律法规、中国证监会及上交所规范性文件禁止购买者除外)  
承销方式:余额包销  
上市证券交易所:上海证券交易所  
预计募集资金总额:【1】亿元  
拟扣除发行费用后的募集资金净额:【1】亿元  
共 5,016.67 万元,其中承销及保荐费 3,301.89 万元,审计及验资费 763.02 万元,律师费 383.21 万元,用于本次发行的信息披露费 502.83 万元,发行手续费 59.73 万元(上述费用均不含增值税费用,发行费用总额与各项费用相加不等于募集资金总额)

**第三节 发行人基本情况**

一、基本情况

中文名称	嘉兴斯达半导体股份有限公司
英文名称	StarPower Semiconductor Ltd.
统一信用代码	913304007731328302
注册资本	12,000 万元
法定代表人	沈华
成立日期	2006 年 4 月 27 日
股票变更日期	2011 年 11 月 30 日
住所	嘉兴市南湖区兴科路 988 号(嘉兴科技城)
邮政编码	314006
互联网网址	www.powersemi.com
电子邮箱	investor-relation@powersemi.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
信息披露及投资者关系负责人	张哲
电话	0573-8258 6999
传真号码	0573-8258 8229
经营范围	半导体芯片、电子元器件的设计、生产和销售。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制外商投资经营的项目)

嘉兴斯达半导体股份有限公司系由嘉兴斯达半导体有限公司于 2011 年 10 月整体变更设立,斯达有限以 2011 年 8 月 31 日为基准日经审计的净资产 159,375,587.52 元按 1:0.7529 的比例折合为股份公司总股本 12,000 万股,折股溢价部分计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。

2011 年 11 月 30 日,嘉兴市工商行政管理局对上述变更进行了核准,并换发了注册号为 330400400004928 的股份公司营业执照。

公司前身斯达有限设立于 2005 年 4 月 27 日。斯达有限设立时适用《外商投资企业指导目录(2004 年修订)》,斯达有限从事的新型电子元器件的生产属于鼓励类外商投资产业指导目录的范围,2005 年 4 月 15 日,斯达有限取得浙江省人民政府颁发的《外商投资企业证书》(浙外证字[2005]02957 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》)。公司设立时已经申请办理了外汇登记手续,并取得了国家外汇管理局嘉兴市中心支局核发的《外汇登记证》,编号为 00093961。公司设立符合当时有效的外商投资、外汇管理等相关规定。

(二) 发起人  
公司系由斯达有限整体变更设立,公司的发起人包括法人 8 名、自然人 1 名及有限合伙企业 1 名,具体情况如下:

序号	发起人名称	所持股份数(万股)	股份比例
1	香港斯达	71,266,800	59.39%
2	浙江兴得利	19,796,460	16.50%
3	拜特利投资	10,997,832	9.16%
4	富瑞德投资	9,164,964	7.64%
5	鑫恒投资	4,399,296	3.67%
6	深圳鑫茂	1,319,856	1.10%
7	医药医疗	1,099,644	0.92%
8	宁波展兴	1,099,644	0.92%
9	戴志展	611,004	0.51%
10	华睿金石	244,404	0.20%
	合计	120,000,000	100.00%

(三) 公司设立前主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务  
公司的主要发起人为香港斯达、浙江兴得利、拜特利投资和富瑞德投资。公司改制设立前,香港斯达和富瑞德投资拥有的主要资产为斯达有限的股权;浙江兴得利主要从事棉纺织、化纤、氨纶等产品生产及销售,主要资产除持有发行人股权外,还持有浙江艾美泰克电子科技有限公司(以下简称“艾美泰克”)60%的股权及自身业务相关的资产;拜特利投资主要业务为投资管理及房屋租赁,主要资产除持有发行人股权外,还持有上海新华典当有限公司 50%的股权。

(四) 公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务  
公司系由斯达有限整体变更设立,在设立时整体继承了斯达有限的全部资产、负债及相关业务,拥有独立完整的生产经营所需的固定资产、流动资产和无形资产。公司设立前后资产及实际从事的业务均未发生重大变化,均为以 IGBT 为主的高功率半导体芯片及模块的设计、研发、生产,并以 IGBT 模块形式对外销售。

(五) 公司设立后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务  
主要发起人香港斯达、浙江兴得利、拜特利投资和富瑞德投资拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未因公司形式的变更而发生变化。截至本招股意向书摘要签署日,拜特利投资已不持有本公司股份。

(六) 改制前原企业的业务流程、改制后公司的业务流程,以及原企业与公司业务流之间的联系  
公司系由斯达有限整体变更设立,整体变更前公司业务流程未发生变化。公司的业务流程详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“四、公司主营业务情况”。

(七) 公司设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况  
公司自设立以来,业务和资产完整,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营能力。除股权关系及本招股意向书摘要已披露的关联关系和关联交易外,在生产经营方面与发起人不存在其他关联关系,也没有发生重大变化,具体情况详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“六、关联交易与同业竞争”。

(八) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况  
本公司是依据《公司法》及有关法律法规的规定,于 2011 年 11 月由斯达有限整体变更设立,斯达有限的全部资产和负债由本公司依法继承。截至本招股意向书摘要签署日,斯达有限主要资产产权归属已变更至本公司名下,具体情况详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“五、主要固定资产及无形资产”。

(九) 实际控制人出资情况  
发行人设立时注册资本为 1,000 万美元,并于 2010 年完成足额缴纳。沈华用以出资的 1,000 万美元中,750 万美元为其自有资金,剩余 250 万美元系沈华的个人借款(已还款完毕)。其中,实物出资资产价值由嘉隆(上海)资产评估有限公司出具了万隆评报字[2018]第 10133 号《关于嘉兴斯达半导体股份有限公司》自 2006 年 12 月至 2010 年 6 月止及部分资产出资的五份资产评估报告;资产评估师复核报告以及立信出具了信会师报字[2018]第 Z/A 15679 号《关于嘉兴斯达半导体股份有限公司注册资本实缴收款的复核报告》。公司不存在出资不实或虚假出资的情形。公司前身设立时,沈华已经取得美国《A 人承诺书》,不属于境内居民,且直接持有斯达有限的股权,故不涉及返程投资,无需履行备案程序。

其中,250 万美元个人借款已全部清偿完毕,沈华已与借款方解除全部债权债务关系,不存在任何股权质押的情形。

(十) 公司章程对注册资本缴足时间等事项修改情况  
斯达有限设立时的公司章程的相关规定,“自营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的 15%,全部注册资本在三年内缴清。”2008 年 6 月 23 日,南湖区外经局作出南外经[2008]89 号《关于嘉兴斯达半导体有限公司变更出资期限的批复》,同意将原《公司章程》第三章第十条中有关出资期限的规定变更为:“自公司成立之日起三个月内认缴不低于注册资本 15%,其余部分自公司成立之日起五年内缴清。”

斯达有限延期出资事宜已经南湖区外经局审批,并于 2009 年 12 月对公司章程进行进一步修订并进行了工商登记,工商主管部门予以受理并一并进行了备案,符合《中华人民共和国外资企业法实施细则(2001 修订)》的规定。

2009 年 9 月 22 日,南湖区外经局作出南外经[2009]109 号《关于嘉兴斯达半导体有限公司变更出资方式》的批复》,同意斯达有限股东的出资方式由 499 万美元现汇出资和 501 万美元机械设备出资变更为以 699.6515 万美元现汇出资和 300.3485 万美元机械设备出资,并同意修改后的《公司章程》。2009 年 12 月 14 日,斯达有限就本次出资方式变更取得了换发的《企业法人营业执照》。

斯达有限出资方式变更事宜已经南湖区外经局审批,并向工商主管部门办理了变更登记手续,符合《中华人民共和国外资企业法(2000 年修正)》的规定。

南湖区外经局于 2012 年 2 月 14 日出具了《关于原嘉兴斯达半导体有限公司投资者出资时间问题的确认书》,对出资期限变更事宜进行了确认。2012

年 8 月 1 日,嘉兴市工商局出具了《关于嘉兴斯达半导体股份有限公司历史沿革问题的确认》,确认斯达有限自设立至今的出资均办理了变更登记,无违法违规处罚记录。

三、发行人股本情况  
(一) 本次发行前后的股本结构  
本次发行前公司的总股本为 12,000 万股,本次拟发行人民币普通股不超过 4,000 万股,本次发行股份占发行后总股本不低于 25%,发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	发行前		发行后	
		所持股份数(万股)	股份比例	所持股份数(万股)	股份比例
1	香港斯达	71,266.80	59.39%	71,266.80	44.54%
2	浙江兴得利	2,929.44	24.41%	2,929.44	18.31%
3	富瑞德投资	9,850.50	72.4%	9,850.50	54.3%
4	兴泽投资	5,993.93	49.92%	5,993.93	36.9%
5	宁波展兴	10,996.02	0.92%	10,996.02	0.68%
6	深圳鑫茂	88.79	0.74%	88.79	0.56%
7	天津环拓	76.27	0.64%	76.27	0.48%
8	上海春蓬	76.20	0.63%	76.20	0.48%
9	戴志展	61.10	0.51%	61.10	0.38%
10	芯艺	48.00	0.40%	48.00	0.30%
11	领创投资	24.44	0.20%	24.44	0.15%
	本次发行	-	-	4,000.00	25.00%
	合计	120,000.00	100.00%	160,000.00	100.00%

(二) 前十名股东情况  
本次发行前,公司前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	所持股份数(万股)	股份比例
1	香港斯达	71,266.80	59.39%
2	浙江兴得利	2,929.44	24.41%
3	富瑞德投资	9,850.50	72.4%
4	兴泽投资	5,993.93	49.92%
5	宁波展兴	10,996.02	0.92%
6	深圳鑫茂	88.79	0.74%
7	天津环拓	76.27	0.64%
8	上海春蓬	76.20	0.63%
9	戴志展	61.10	0.51%
10	芯艺	48.00	0.40%
	合计	11,975.56	99.80%

(三) 前十名自然人股东及其在公司任职情况  
公司共有 2 名自然人股东,其持股情况及在公司任职情况如下:

股东名称	所持股份数(万股)	股份比例	在公司任职情况
戴志展	61.10	0.51%	副总经理
芯艺	48.00	0.40%	副总经理

(四) 本次发行前国有股份或外资股份情况  
本次发行前,公司无国有股份的情况。  
本次发行前,公司合计有 3 名外资股东,分别为香港斯达、芯艺和戴志展。外资股东合计持有发行人 72,357,804 股,占公司发行前股本的 60.30%,其具体情况如下:

序号	股东名称	股本	持股比例	主管部门批复或备案文件
1	香港斯达	71,266,800	59.39%	《嘉兴斯达半导体有限公司股权变更的批复》(南湖区外经局作出南外经[2010]1160 号)
2	戴志展	611,004	0.51%	《关于嘉兴斯达半导体有限公司增资的批复》(南外经[2011]1101 号)
3	芯艺	480,000	0.40%	《浙江省商务厅行政权力决定书》(浙商务外资字可[2015]143 号)

(五) 股东中的战略投资者持股  
本次发行前公司无战略投资者。  
(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例  
本次发行前,股东之间不存在任何关联关系。  
(七) 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺  
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股意向书摘要的“重大事项提示”之“一、关于股份锁定的承诺”。  
(八) 发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况  
公司不存在内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。  
四、公司主营业务情况  
(一) 主营业务  
公司主营业务为以 IGBT 为主的高功率半导体芯片及模块的设计、研发、生产,并以 IGBT 模块形式对外实现销售。IGBT 模块的核心是 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力。  
自 2005 年成立以来,公司一直致力于 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片的设计及 IGBT 模块的设计、制造和测试,公司的主要业务及主要产品均未发生过变化。报告期内,IGBT 模块的销售收入占公司营业收入总额的 95%以上,是公司的主要产品。  
(二) 主要产品  
公司目前主要产品为 IGBT 模块,其实物外观示例如下:



公司的主要 IGBT 模块产品的具体情况如下:

图 6-3 公司主要 IGBT 模块产品情况

产品系列	电压范围	典型应用领域
C1	50A-100A	变频器、逆变器、感应加热、UPS
C2/C23	100A-400A	变频器、感应加热、电焊机
B3/B3.1/B3.2	100A-400A	新能源汽车、电动汽车
C2.1	400A-600A	变频器、UPS
C8/C8.1	100A-200A	UPS、电焊机
C3	800A-2400A	大功率变频器、机车牵引
C3.1	600A-1200A	大功率变频器、机车牵引
C4	1800A-3900A	大功率变频器、机车牵引、风力发电、智能电网
P1	600A-900A	风力发电、光伏发电、新能源汽车
P2	1000A-1400A	风力发电、光伏发电、新能源汽车
P3	225A-400A	新能源汽车
P4	400A-800A	新能源汽车
C5	10A-40A	变频器
C5	10A-150A	变频器、UPS
OR.1	225A-600A	变频器、风力发电、光伏发电、新能源汽车
A7	225A-600A	变频器、风力发电、光伏发电、新能源汽车
C1	10A-30A	变频器、变频器
PL12/PL14/PL17/PL18/PL19/PL23/PL25	6A-35A	小功率变频器、光伏发电
IPM	5A-50A	智能模块

IGBT 是现代电力电子领域的代表性器件,由于其具有导通电阻小、开关速度快、工作频率高等特点,可以在各种电路中提高功率转换、传送和控制的效率,实现节能降耗、提高工业控制水平的目的。公司的 IGBT 模块工艺齐全,在工业控制及自动化、新能源汽车、电机节能、太阳能发电、风能发电等诸多领域都有广泛的应用。

以新能源汽车为例,新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”系统,主要是指电机、电池、电控。“三电”中电控系统的主要作用是接收整车控制器的指令,进而控制驱动电机的转速和转矩,以控制整车的运动。另外,在制动阶段,电机控制器负责将驱动电机的回馈能量进行回收并储存在动力电池以提高电能利用率。IGBT 模块为电控系统的核心器件,担负着电控系统中动力电池直流感应电机电机所需交变变频电能的任务,IGBT 模块决定了整车的电能转换效率。

公司主要产品应用领域示意图如下:



(三) 公司主要业务模式  
1. 采购模式

公司的原材料主要包括 IGBT 芯片、快恢复二极管芯片等其他半导体芯片、DBC 板、散热器板、其他材料等。其中 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片的采购主要通过自主研发设计并外协生产加工,以及向国外生产商或代理商直接采购两种方式;DBC 板等原材料部分向国外企业直接采购,部分向国内厂商进行采购,在保证质量的前提下降低成本;其他原材料主要向周边地区供应商直接采购,部分进口。公司向国外供应商采购的原材料主要通过欧元、美元、瑞士法郎等外币结算。

IGBT 芯片主要区别于 IGBT 器件设计和制造工艺。公司自主研发设计的芯片均由技术人员独立研发,且公司对相关的自主设计已申请了专利,不存在侵犯外购芯片知识产权的情形,不存在法律纠纷或潜在纠纷。

公司在采购国内原材料时,先由相关部门根据生产需求,提前两个月提出采购申请递交到采购部,由采购部根据供应商的交货周期下单及安排供应商送货,同时,根据公司预测,供应商会为公司预备一定的物料,以满足公司临时的生产调整。

采购国外原材料时,由于交货期较长,公司根据生产需求,对不同不同供应商交货计划表,根据未来六个月的物料需求预测提前下单,并根据实际生产需要提前做好交货计划表,以确保供应商能及时供货。同时公司也会根据供需状态储备一定水平的安全库存,确保在上游供货需求变化时能及时满足客户需求。

为了确保产品质量,公司具有严格的供应商准入流程,新的供应商人均需经过公司采购、技术和品质部门人员的共同审核。此外,公司对各种原材料均制订了具体的检验标准,原材料投入使用前需先经过检验。

公司在选择供应商时,综合考虑其综合实力、产品质量、供应产品的稳定性以及报价情况,选择性价比最高的供应商进入供应体系;公司拥有成熟的供应链管理,在产品采购过程中对供应商进行绩效评价和管理。

公司 IGBT 芯片和快恢复二极管芯片通过自主研发设计并外协生产加工是指公司负责 IGBT 器件设计和制造工艺,并向上海先进和上海华虹两家公司外包提供芯片设计图样和对应的生产工艺,最终由其负责制造生产。公司芯片外协代工工厂基本情况如下:

(1) 上海先进半导体制造有限公司基本情况

公司名称	上海先进半导体制造有限公司
成立日期	1988年 10月 4日
注册资本	153,422.70 万元人民币
经营范围	集成电路和半导体芯片的制造、封装、测试及相关服务;与集成电路有关的开发、设计服务;技术服务与咨询;光电器制造;在国内外销售公司产品及就公司产品提供售后服务
外部服务情况	为公司提供 IGBT 和快恢复二极管相关产品的芯片代工服务

(2) 上海华虹宏力半导体制造有限公司基本情况

公司名称	上海华虹宏力半导体制造有限公司
成立日期	2013年 1月 24日
注册资本	782,887.750 万元人民币
经营范围	集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、销售、销售集成电路产品及相关技术支持、销售自产产品
外部服务情况	为公司提供 IGBT 芯片相关产品的代工服务

此外,上海先进半导体制造有限公司还为诸多其他公司提供提供芯片外协代工服务。

(三) 上海华虹宏力半导体制造有限公司基本情况

注:上海先进为 2018 年 6 月 30 日披露的股东持股情况;上海华虹为 2019 年 4 月 4 日披露的股东持股情况

序号	股东名称	持股比例
1	上海先进	27.27%
2	上海华虹	15.22%
3	芯艺	18.88%
4	NBC Corporation	7.71%
5	华丰半导体有限公司	19.65%
6	上海化学工业区(香港)有限公司	14.51%
7	Pudong Science and Technology Investment (Cayman) Co., Ltd.	13.32%
8	芯艺有限公司	13.32%
9	上海贝岭股份有限公司	5.78%

公司未直接控制上海先进和上海华虹,外协厂商与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系或亲属关系。公司与外协厂商间仅在正常的业务合作情况,除此以外各自保持独立经营,外协厂商不存在为公司承担成本或费用的情况。

2. 生产模式  
公司产品为 IGBT 模块,属于半标准化产品,公司会根据下游客户行业具体的需求,对产品电压、电流、功率、封装结构等参数进行设计,开发成不同系列的产品,产品整体生产流程具备标准化。因目前公司采取接单生产和根据预测备货相结合的方法,一方面会根据客户的实时需要,在签订合同后组织采购和生产,另一方面会根据客户对下游市场的了解及与客户沟通,提前生产备货。发行人产品虽然会根据客户需求设计并生产,但不属于定制化产品,发行人与客户不构成外协加工关系。

对于 IGBT 芯片及快恢复二极管芯片,公司采取 Fabless 模式,从而能够专注于芯片设计并加快芯片开发速度;对于 IGBT 模块,公司专注于核心生产工序,同时为了降低生产成本,将部分技术含量相对不高的生产环节,如功率端子电镀等委托给其他企业进行。

3. 营销模式  
目前公司主要采取直销的方式进行销售,公司直销的主要业务领域为:客户开发——产品测试——小批量试用——大批量稳定销售。公司根据下游客户的分布情况,除嘉兴总部外在全国建立了 5 个销售联络处,并于瑞士设立了控股(公司)斯达欧洲、负责国际市场业务开拓,同时公司亦参加相关行业的展会及相关行业组织的各种会议、活动等,以提高产品知名度,加强和客户沟通,促进市场开发和产品销售。

因为 IGBT 模块海外市场地域分布较广,且海外代理商及客户相对成熟,因此,公司从 2014 年开始针对部分海外市场通过经销商销售给终端客户。经销模式主要通过经销商对外销售,公司根据经销商的订单发货给经销商,最后由其发货给终端客户。公司选择经销商时主要考评经销商的销售网络以及技术人员能力(主要协助完成客户支持及后期维护)。

报告期内,公司直销和经销的金额及比例情况如下表所示:

地区	销售模式	2019年 1-6 月		2018年度		2017年度			
		金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比		
国内	直销模式	33,682.16	91.91	63,042.00	93.35	40,698.41	92.92	28,082.54	93.40
	经销模式	838.97	2.28	1,177.40	1.74	288.70	0.68	52.46	0.17
	小计	34,521.13	94.20	64,220.20	95.09	40,987.11	93.61	28,135.00	93.58
国外	直销模式	1,807.38	4.93	2,903.23	4.30	2,248.77	5.13	1,647.72	5.48
	经销模式	316.47	0.86	413.34	0.61	551.36	1.26	283.66	0.94
	小计	2,123.85	5.80	3,316.57	4.91	2,800.13	6.39	1,931.38	6.42
合计		36,644.98	100.00	67,536.77	100.00	43,787.24	100.00	30,066.38	100.00

IGBT 模块是下游客户产品中的关键零部件,产品成本较高。因此,公司在客户早期开发阶段难度较大,需要经过较长时间的样品测试认证、试用。此外,客户对新供应产品的采购数量在初期也会相对较少,但一旦公司产品质量获得客户认可,结合公司在本土化、成本等方面的优势,客户采购往往会有较快增加,由于替换成本较高,使得公司产品维护成本相对较低。公司作为国内少数实现大规模量产的 IGBT 模块企业之一,目前的主要竞争对手是国外企业,与之相比,公司在细分领域、本土化、成本等方面均具有一定优势。此外,为了维护良好的客户关系,及时响应客户需求,公司于 2007 年即设立了客户服务部,除日常客户服务外,还负责搜集市场信息,根据公司计划制定并分解各阶段销售目标,对客户进行信用评估、跟踪服务等。

(四) 公司在行业中的市场份额及变化情况  
公司多年来一直专注于 IGBT 相关技术的研发,自 2005 年成立以来,经历了早期的市场开拓后,目前已成为少数实现 IGBT 大规模生产的国内企业之一,是国内多家知名工业控制企业的主要 IGBT 模块供应商,先发优势明显。

与国外竞争对手相比,公司市场份额仍较小,目前公司的主要竞争优势在于在更加专注于细分市场以及更加及时地响应客户需求的同时,在产品价格上具备一定优势。公司自主研发设计的 IGBT 芯片及快恢复二极管芯片已经实现量产,在一定程度上化解了公司在芯片供应上依赖国外供应商的问题。未来公司的市场份额仍有较大的提升空间。

国内目前也有少数企业在进行 IGBT 模块相关的研发,但国内实现 IGBT 模块大批量生产的企业仍较少,目前公司在 600V-1700V IGBT 模块的技术水平及生产规模上均处于领先地位。

2011 年,公司荣获中国电子技术学会电气节能专业委员会颁发的“电气节能领域高速发展企业奖”、“IGBT 系列产品知名品牌奖”等。

2012 年,公司获得中国电子技术学会颁发的“IGBT 模块领军企业奖”。

2015 年,更获得了中国电子技术学会电气节能专业委员会颁发的 IGBT 行业“世界一流产品奖”。

2017 年,公司被嘉兴科技城管理委员会评为“科技创新先进企业”。

2011 年至 2017 年,公司多次获得英威腾颁发的“优秀供应商奖”、“金牌供应商”的奖项。

2018 年,公司获得大阳电机车事业集团颁发的“优秀供货奖”。

2018 年,公司获得合肥一厂颁发的“年度优秀供应商”奖项。

随着公司产能的扩张,产品线的丰富和知名度的进一步提升,公司销售规模将进一步扩大,未来公司的市场占有率将保持上升趋势。

(五) 主要竞争对手的简要情况  
根据 IHSMarkit 2018 年报告统计数据,2017 年全球 IGBT 模块市场约为 47.9 亿美元。根据集邦咨询《2019 中国 IGBT 产业发展及市场报告》显示,2017 年中国 IGBT 市场规模预计为 128 亿人民币,2018 年中国 IGBT

市场规模预计为 153 亿人民币,相较 2017 年同比增长 19.91%。受益于新能源汽车和工业领域的需求大幅增加,中国 IGBT 市场规模仍将持续增长,到 2025 年,中国 IGBT 市场规模将达到 522 亿人民币,年复合增长率达 19.11%。

目前 IGBT 市场仍主要由境外企业垄断,且构成竞争的企业不超过 10 家。根据 IHSMarkit 2018 年报告统计数据,IGBT 模块前十大供应商占据市场份额超过 75%,公司是目前全球市场份额唯一一家中国企业,因此公司竞争对手主要是境外 IGBT 模块制造商。

公司目前的同行业竞争对手主要是国外跨国公司,包括英飞凌、三菱、富士、赛米控等。

公司主要竞争对手的具体情况如下:

1. 英飞凌科技(Infineon Technologies)  
英飞凌科技的前身是西门子集团的半导体部门,于 1999 年独立。公司总部位于德国慕尼黑,是全球领先的半导体公司之一。根据英飞凌最新的季度报告,截至 2019 年 3 月 31 日,公司员工人数达 41,449 人,人员覆盖欧洲、亚洲及北美洲。公司的主营业务涉及汽车、芯片卡与安全、工业电源控制和电源管理四个方面。

英飞凌科技作为行业龙头,是 IGBT 技术领导者,根据 IHSMarkit 2018 年报告,2017 年全球市场占有率为 22.40%,对于低电压、中电压和高电压 IGBT 领域,英飞凌均占据领先地位。

2. 三菱电机株式会社(Mitsubishi Electric Corporation)  
三菱电机株式会社是三菱集团的核心企业之一,成立于 1921 年。根据三菱电机株式会社 2019 年年报,截至 2019 年 3 月 31 日,公司员工数量达 145,817 人。三菱电机在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据着重要的地位。三菱电机半导体产品包括功率模块(IGBT、IPM、MOSFET 等)、微波/射频和高频光器件、光模块和标准工业用的 TFTLCD 等。

作为全球领先的 IGBT 企业,三菱电机在中等电压、高压 IGBT 领域处于领先地位。根据 IHSMarkit 2018 年报告,2017 年全球市场占有率为 17.90%,仅次于英飞凌。

3. 富士电机株式会社(Fuji Electric)  
富士电机株式会社成立于 1923 年,根据富士电机株式会社官网数据,其在国内拥有十个工厂和一个综合研究所,在海外有 129 个子公司和分支机构,年销售额在八十亿日元左右。根据富士电机株式会社最新季度报告,截至 2019 年 6 月 30 日,公司员工数量达 27,674 人。旗下的富士电机电子技术株式会社负责半导体元件的生产及销售。富士电机在全球生产及销售 IGBT、MOSFET 等功率半导体。富士电机 IGBT 芯片的设计和主要生产集中在本国进行,在英国、日本和菲律宾都设有功率器件生产工厂。

作为业内领先的 IGBT 企业,富士电机主要生产 IGBT 模块和 IPM 模块,产品在工业控制和变频器中广泛使用。根据 IHSMarkit 2018 年报告,2